

性能指标	典型值 <sup>(1)</sup>			方向	单位	条件	测试方法
	RO3203	RO3206	RO3210				
介电常数, $\epsilon_r$ 过程	3.02 ± 0.04	6.15 ± 0.15	10.2 ± 0.50	Z	-	10GHz 23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5 带状线
<sup>(2)</sup> 介电常数, $\epsilon_r$ 设计	3.02	6.60	10.80	Z	-	8GHz -40 GHz	差分相位法
损耗因子 $\tan \delta$	0.0016	0.0027	0.0027	Z	-	10GHz 23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
$\epsilon_r$ 热系数	-13	-212	-459	Z	ppm/°C	10GHz 0-100°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
尺寸稳定性	0.8	0.8	0.8	X,Y	mm/m	COND A	ASTM D257
体电阻	10 <sup>7</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>3</sup>		MΩ-cm	COND A	IPC2.5.17.1
表面电阻	10 <sup>7</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>3</sup>		MΩ	COND A	IPC2.5.17.1
拉伸模量	409 351	462 462	579 517	MD,CMD	kpsi	23°C	ASTM D638
吸水率	<0.1	<0.1	<0.1	-	%	D24/23	IPC-TM-650 2.6.2.1
特征热量	0.95	0.85	0.79		J/g/K		Calculated
热导率	0.48	0.67	0.81	-	W/m/K	80°C	ASTM C518
热膨胀系数	13 58	13 34	13 34	X, Y Z	ppm/°C	-55 至 288°C	ASTM D3386-94
Td	500	500	500		°C	TGA	ASTM D3850
颜色	棕褐色	棕褐色	米白色				
密度	2.1	2.7	3.0		gm/cm <sup>3</sup>		
铜箔剥离强度	10.2	10.7	11.0		pli	1 oz. EDC 经过漂锡	IPC-TM-2.4.8
阻燃性	V-0	V-0	V-0				UL 94
无铅焊接兼容性	是	是	是				

标准厚度	标准平板面积	标准覆盖铜层
RO3203: 0.010" (0.25mm) 0.020" (0.50mm) 0.030" (0.75mm) 0.060" (1.52mm)	12" X 18" (305 X 457mm) 24" X 18" (610 X 457mm)	½ oz. (17µm) 电镀铜层 (HH/HH) & 压延铜 (5R/5R) 1 oz. (35µm) 电镀铜层 (H1/H1) & 压延铜 (1R/1R) 2 oz.(70µm) 电镀铜层 (H2/H2)& 压延铜 (2R/2R)
RO3206/RO3210: 0.025" (0.64mm) 0.050" (1.28mm)	12" X 18" (305 X 457mm) 24" X 18" (610 X 457mm)	½ oz. (17µm) 电镀铜层 (HH/HH) 1 oz. (35µm) 电镀铜层 (H1/H1) 2 oz. (70µm) 电镀铜层 (H2/H2) 其他可用覆铜方法请联系客服

如您需要微波高频线路板的技术支持或报价服务, 请联系 iPcb.cn, 邮箱: sales@iPcb.cn 或者进入网站自动报价: www.iPcb.cn